

证券代码：002916

证券简称：深南电路

## 深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-12

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>电话会议</u> ）
参与单位名称及人员姓名(排名不分先后)	东吴证券、UBS 瑞银证券、台湾永丰金证券、天风证券
时间	2021年7月2日-7月7日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	证券事务代表：谢丹。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>交流主要内容：</p> <p><b>Q1、请简要介绍公司广州封装基板生产基地项目。</b></p> <p>公司拟以自有资金及自筹资金 60 亿元在广州设立封装基板生产基地。项目主要产品为 FC-BGA、FC-CSP 及 RF 封装基板。公司拟在广州成立全资子公司作为广州封装基板项目的实施主体。目前项目整体进展处于拟参与竞拍土地使用权的前期阶段。整个项目建设周期分为两期，公司将在完成子公司设立、土地招拍挂等前期事项后，分阶段开展项目建设。</p> <p><b>Q2、请介绍公司对广州封装基板项目的投资规划。</b></p> <p>广州封装基板项目总投资金额约 60 亿元人民币，资金来源为公司自有资金及自筹资金。公司会根据项目建设的具体执行情况，以滚动式投资的方式分期投入资金。</p>

**Q3、请介绍公司深圳、无锡封装基板工厂与广州封装基板项目在产品定位上的区别。**

公司目前现有深圳 2 家、无锡 1 家封装基板工厂，其中深圳封装基板工厂主要面向 MEMS 微机电系统封装基板、指纹模组、RF 射频模组等封装基板产品；无锡封装基板工厂主要面向存储类封装基板，且具备 FC-CSP 产品技术能力。广州封装基板项目主要面向 FC-BGA、RF 及 FC-CSP 封装基板产品。目前公司现有工厂已具备 RF 封装基板与 FC-CSP 封装基板的批量生产能力，FC-BGA 封装基板技术将在现有平台基础上进行深度孵化，公司目前已投入对 FC-BGA 封装基板产品技术的研发。

**Q4、请介绍目前封装基板的市场前景。**

随着 5G 建设及应用的逐步推进，数据中心、智能驾驶、AI、高性能计算等领域需求热度持续高涨，其所需的主要核心 IC 市场规模迎来高速增长的机会。同时，随着 5G 手机等终端数量逐年增加，手机等智能终端所需的应用处理器、射频模组等 IC 需求也稳步增长。封装基板作为集成电路封装的核心材料之一，具有广阔的市场前景。

**Q5、请介绍公司封装基板业务主要客户类型。**

公司封装基板业务客户主要包含 IDM 类（集成器件制造商）、Fabless 类（半导体设计商）以及 OSAT 类（半导体封测商）客户。

**Q6、请介绍公司封装基板业务进入 FC-BGA 领域所进行的资源储备。**

FC-BGA 为高阶封装基板产品，具备高多层、高精细线路等特性，有较高的技术壁垒，对公司封装基板人才的培养和储备有较高要求。产品所涉及的原材料、设备也主要依赖于进口。

在技术层面，公司现有工厂已具备 FC-CSP 基板的批量生产能力，有较完善的精细线路产品技术能力以及质量能力平台，FC-BGA 基板技术将在现有平台基础上进行深度孵化；公司也将积极引入该领域的技术专家人才，加快工艺制程开发。

在人才储备层面，公司经过 10 多年发展，已形成了一批专业基板人才，并已针对性地开展重点人才储备工作，打造后备梯队人才资源池，提升自主培育人才的综合能力。

在原材料、设备供应层面，公司已与主要原材料供应商达成合作意向，将积极保障

	<p>原材料供应；相关设备主要由现有成熟供应商提供，公司与供应商合作稳定，并将继续保持良好合作关系，确保设备按期交付。</p> <p><b>Q7、请介绍公司南通数通二期工厂产能爬坡进展。</b></p> <p>南通数通二期工厂于2020年3月份连线试生产，产能爬坡进展顺利，目前已达到PCB业务综合产能利用率水平。达产后生产能力预计为58万平方米/年。</p> <p>注：调研过程中公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单	无
日期	2021年7月9日